

Embedded Vision Alliance zeichnet REAL3 Bildsensor als „Produkt des Jahres“ aus

München – 23. Mai 2019: Als Unterscheidungsmerkmal müssen Smartphone-Kameras zunehmend dreidimensional „sehen“. Die Infineon Technologies AG hat in Zusammenarbeit mit der pmdtechnologies ag mit dem REAL3™ IRS2381C eine führende 3D-Imager-Sensorlösung entwickelt, die speziell für mobile Geräte entwickelt wurde. Die Embedded Vision Alliance hat die 3D Time-of-Flight (ToF) Single-Chip-Lösung nun als „Produkt des Jahres“ in der Kategorie „Sensoren“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt die Errungenschaften führender Technologien, Dienstleistungen und Produkte von Unternehmen, die die nächste Generation von Anwendungen für die Computervision ermöglichen.

„Ich gratuliere Infineon zur Auszeichnung des besten Sensors bei den ‚Vision Product of the Year Awards‘ 2019“, sagte Jeff Bier, Gründer der Embedded Vision Alliance. „Innovative Sensordesigns wie der 3D-Bildsensor von Infineon ermöglichen neue Erlebnisse beim dreidimensionalen Sehen – etwa Gesichtserkennung für Smartphones und Augmented Reality. Infineon hat eine Vorreiterrolle bei 3D-Bildsensoren für visuelle KI-Anwendungen. Ich bewundere das Engagement des Unternehmens in puncto Innovation und Qualität in diesem unglaublich dynamischen Markt. Ich begrüße es sehr, dass Infineon Mitglied der Embedded Vision Alliance ist und diese herausragenden Preis erhalten hat.“

„Wir danken der Embedded Vision Alliance für den ‚Product of the Year Award‘, der unsere Innovation und die Leistung des REAL3 ToF-basierten 3D-Imagers würdigt“, sagte Philipp von Schierstaedt, Vice President, RF & Sensors bei Infineon. „Mit der Erfahrung von Infineon und pmdtechnologies bietet der neuartige Sensor eine neue Dimension von 3D-Kamerafunktionen für mobile Geräteanwendungen. Der REAL3 ToF-Sensor von Infineon ermöglicht ein einzigartiges Benutzererlebnis bei sicherer Gesichtsaufführung, computergestützter Fotografie und nahtlosen AR-Anwendungen.“

Time-of-Flight (ToF) ist die führende Aufnahmetechnologie für 3D-Kameras in mobilen Geräten. Sie wird mit zu dem erheblichen Marktwachstum bei 3D-Aufnahmen beitragen, das für die kommenden Jahre erwartet wird. „Time-of-Flight“ beschreibt die Zeit, in der die Photonen von der Kamera zum jeweiligen Objekt und zurück zum REAL3-Sensor gelangen. Dahinter steht eine beispiellose Innovation: Sie ermöglicht die nächste Stufe sicherer Interaktionen mit Smartphones.

Der preisgekrönte IRS2381C-Bildsensor ermöglicht qualitativ hochwertige und sichere dreidimensionale Bildaufnahme in Echtzeit. Die herausragende Leistung kann bei allen Lichtverhältnissen erzielt werden und somit auch im Freien. Gegenüber anderen 3D-Technologien wie Structured Light reduziert die ToF-Technologie von Infineon und pmd die Anzahl der Schlüsselkomponenten von drei auf zwei. Die direkte Entfernungsmessung erfordert zudem die geringste Rechenleistung im Prozessor. Insgesamt wird die Anwendung somit wesentlich zuverlässiger, kompakter und kostengünstiger, während zugleich der Stromverbrauch deutlich sinkt.

Verfügbarkeit

Der neue 3D-Bildsensorchip wurde in Graz, Dresden und Siegen entwickelt und bündelt das Know-how der Standorte in einer einzigen Lösung. Der IRS2381C wird in bewährter Volumenproduktion gefertigt und durchläuft werksseitig einen schnellen Kalibrierprozess für die gesamte Lebensdauer. Für Hersteller von 3D-Kameras bietet er sich somit als bevorzugter Bildsensor für Anwendungen in mobilen Geräten an. Weitere Informationen zum 3D-Bildsensor von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/real3.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Information über REAL3™ sind unter www.infineon.com/real3 verfügbar.

Über die pmdtechnologies ag

Die pmdtechnologies ag, ein fabless IC-Unternehmen mit Sitz in Siegen (Deutschland), San Jose (USA), Seoul (Korea) und Shanghai (China), ist der weltweit führende Anbieter für CMOS-basierte, digitale 3D Time-of-Flight Bildsensor Technologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und besitzt über 350 Patente weltweit, die sich mit pmd-basierten Anwendungen, dem pmd-Messprinzip und dessen Umsetzung befassen. 3D-Sensoren von pmd bedienen die Zielmärkte industrielle Automatisierung, Automotive und das breit gefächerte Feld der Consumer Anwendungen wie z.B. in Smartphones. Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter pmdtec.com.

pmdtechnologies ag | contact

Sabrina Buxbaum

Director Corporate Strategy & Marketing

Phone: +49 271 238 712 800

E-Mail: s.buxbaum@pmdtec.com

Infineon Technologies AG | contact

Gregor Rodehueser

Press Spokesperson

Markets & Business Development

Phone: +49 89 234 28 481

E-Mail: gregor.rodehueser@infineon.com